

- ◆ **DISTRIBUTION DE PRODUITS CHIMIQUES  
POUR L'INDUSTRIE ET LA CHIMIE FINIE.**
- ◆ **IMPORT / EXPORT DE PRODUITS  
CHIMIQUES.**
- ◆ **PRODUITS ET EQUIPEMENTS  
POUR L'ELECTRONIQUE.**
- ◆ **ETUDE ET DEVELOPPEMENT DE PROCESS  
DE NETTOYAGE DE PRECISION.**
- ◆ **ASSISTANCE A LA GESTION  
DES DECHETS INDUSTRIELS  
REPRISE DES PRODUITS USES.**
- ◆ **MODIFICATION ET ADAPTATION  
DE VOS MATERIELS DE NETTOYAGE.**
- ◆ **CENTRALE D'ACHATS**



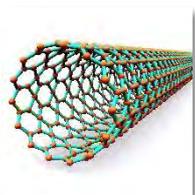
5, Place de l'Eglise  
77400 Saint Thibault des Vignes  
Tél : 00 33 (0)1 64 30 89 22  
Fax : 00 33 (0)1 64 30 87 49  
E-Mail : [contact@service-chimie.fr](mailto:contact@service-chimie.fr)  
Web : [www.service-chimie.fr](http://www.service-chimie.fr)

**Pour le nettoyage et séchage de haute précision sans CFC, ni HCFC, ni Bromé et aucun produit CMR**

Les contaminants tels que les huiles, graisses, pâtes à polir, contamination particulaire, crème à braser, flux de soudure, résidus ioniques sur cartes électroniques peuvent être enlevés par un des produits de la gamme SERSOLV®.



**MÉCANIQUE DE PRÉCISION**



**NANOTECHNOLOGIE**



**AÉROSPATIALE AÉRONAUTIQUE**



**ÉLECTRONIQUE MICROÉLECTRONIQUE**



**LUNETTERIE**



**ENERGIE**



**OPTIQUE**



**AUTOMOBILE**



**MÉDICAL**



**HORLOGERIE**



**SALLE BLANCHE**



**ORFÈVRERIE**

## SOLVANTS HALOGÉNÉS / MACHINE PHASE VAPEUR

## GAMME SERSOLV® 3 T

Les SERSOLV® 3 T sont basés sur les HFC (hydrofluorocarbones) élaborés à partir de mélanges azéotropiques ininflammables. Les HFC possèdent une valeur nulle pour le potentiel de destruction de l'ozone (ODP = 0) et un bas potentiel d'effet de serre.

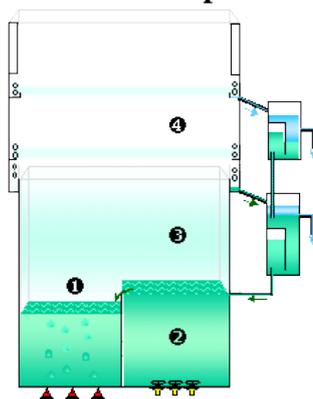
Les SERSOLV® 3 T sont principalement utilisés pour le nettoyage, départiculage, rinçage et séchage et aussi comme fluide de dépoussiérage. Elle offre une bonne stabilité chimique et thermique ainsi qu'une très vaste compatibilité avec les matériaux à nettoyer (métaux, plastiques, élastomères).



**Les SERSOLV® 3 T s'utilisent seuls ou en association avec des co-solvants.**

*Pour utilisation en machine phase vapeur, en enceinte fermée ou des nettoyages manuels avec système d'aspiration des vapeurs.*

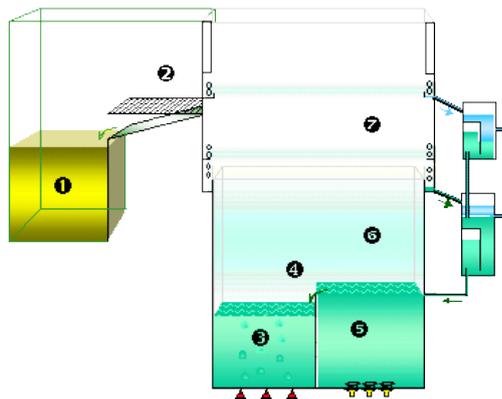
### Solvant halogéné pur / azéotrope



Temps de cycle total : 3 à 6 mn

- 1/ Nettoyage
- 2/ Finition de nettoyage
- 3/ Rincage (solvant pur)
- 4/ Séchage

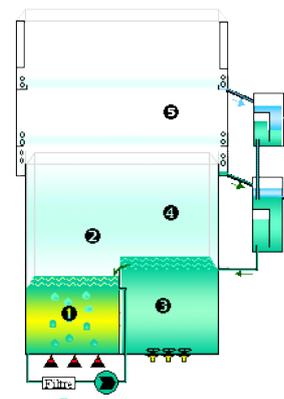
### Solvant halogéné + pré-solvants



Temps de cycle total : 5 à 10 mn

- 1/ Pré-nettoyage
- 2/ Egoutage optionnelle
- 3-4 / Nettoyage immersion ou vapeur
- 5/ Finition de nettoyage
- 6/ Rincage (solvant pur)
- 7/ Séchage

### Solvant halogéné + co-solvant



Temps de cycle total : 3 à 8 mn

- 1/ Nettoyage en co-solvant
- 2/ Egoutage séparation co-solvant
- 3/ Finition de nettoyage
- 4/ Rincage (solvant pur)
- 5/ Séchage

SERSOLV® 3 T-SV est, compte tenu de ses propriétés, une excellente solution de substitution du CFC 113 et HCFC 141b. Ce produit fabriqué en France remplace dans de nombreuses applications les produits américains Vertrel et HFE type HFC 43.10 et HFE 7100 et 7200 tout en étant nettement plus économique.

Ces caractéristiques lui permettent de remplacer le TRICHLOROETHYLENE dans de nombreux cas de nettoyage de haute précision.

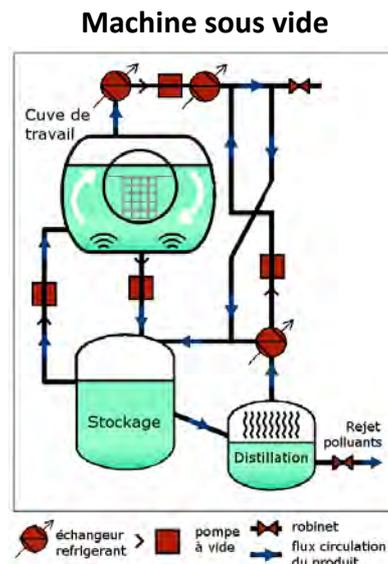
SERSOLV® 3 T-SV est une base très intéressante pour la formulation de nombreux produits de dégraissage, départiculage et défluxage dans les hautes technologies.

## SOLVANTS TYPE A3 / MACHINE SOUS VIDE

Lorsque la technologie du nettoyage sous vide est choisie Service Chimie met a votre disposition les Gammes :  
SERSOLV® AP et SERSOLV® X.

- Spécialement développées pour les installations adaptées aux solvants ayant un point éclair supérieur à 55°C, de type A3.
- Machine fermée, étanche, distillation par dépression.

Compte tenu de leur pouvoir solvant, elles constituent l'une des meilleures solutions de remplacement pour les solvants chlorés :  
Trichloéthylène, Perchloroéthylène, Chlorure.



## SOLVANT TYPE ALCOOL MODIFIÉ

## GAMME SERSOLV® AP

Formulés à partir d'agents polaires oxygénés, les SERSOLV® AP sont aussi bien efficaces sur les huiles et les graisses que sur les substances polaires.

Les SERSOLV® AP sont facilement régénérables par distillation. Exemptés d'hydrocarbures ils ne laissent aucun film gras sur les pièces, ce qui permet d'atteindre les plus hauts niveaux de propreté. Et ainsi répondre aux plus hautes exigences de qualité.

Ses composants polaires et apolaires lui confèrent un large domaine d'application pour les salissures les plus diverses.

Efficace sur :

- Ne corrode pas
- Bonne qualité de séchage
- Bonne viscosité
- Faible odeur
- Exempt de tout composé halogéné
- Les huiles
- Les graisses
- Empreintes de doigts
- Les résidus de flux de soudure
- Les dépôts de crème à brasser
- Les traces de colle CMS
- Colle conductrice

## SOLVANT TYPE ISOPARAFFINIQUE

## GAMME SERSOLV® X

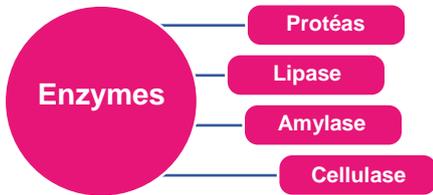
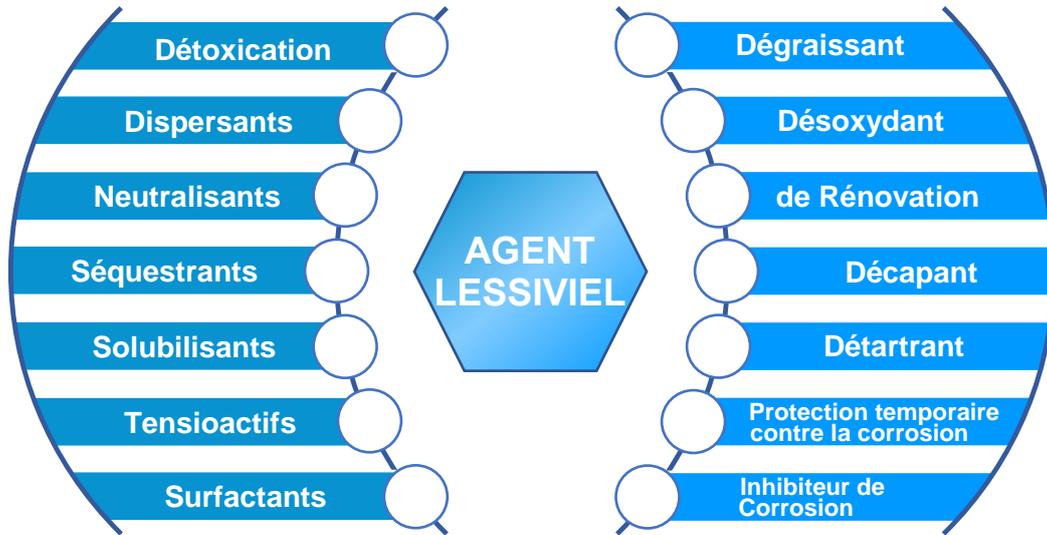
Formulés à basse d'hydrocarbure, les SERSOLV® X sont parfaitement adaptés à l'élimination des huiles entières. Les solvants isoparaffiniques ne contiennent pratiquement aucun composé aromatique, ils sont totalement saturés et quasiment inodores.

La structure isoparaffinique de la gamme des SERSOLV® X leur confère un degré de pureté élevé et des propriétés particulières, comme :

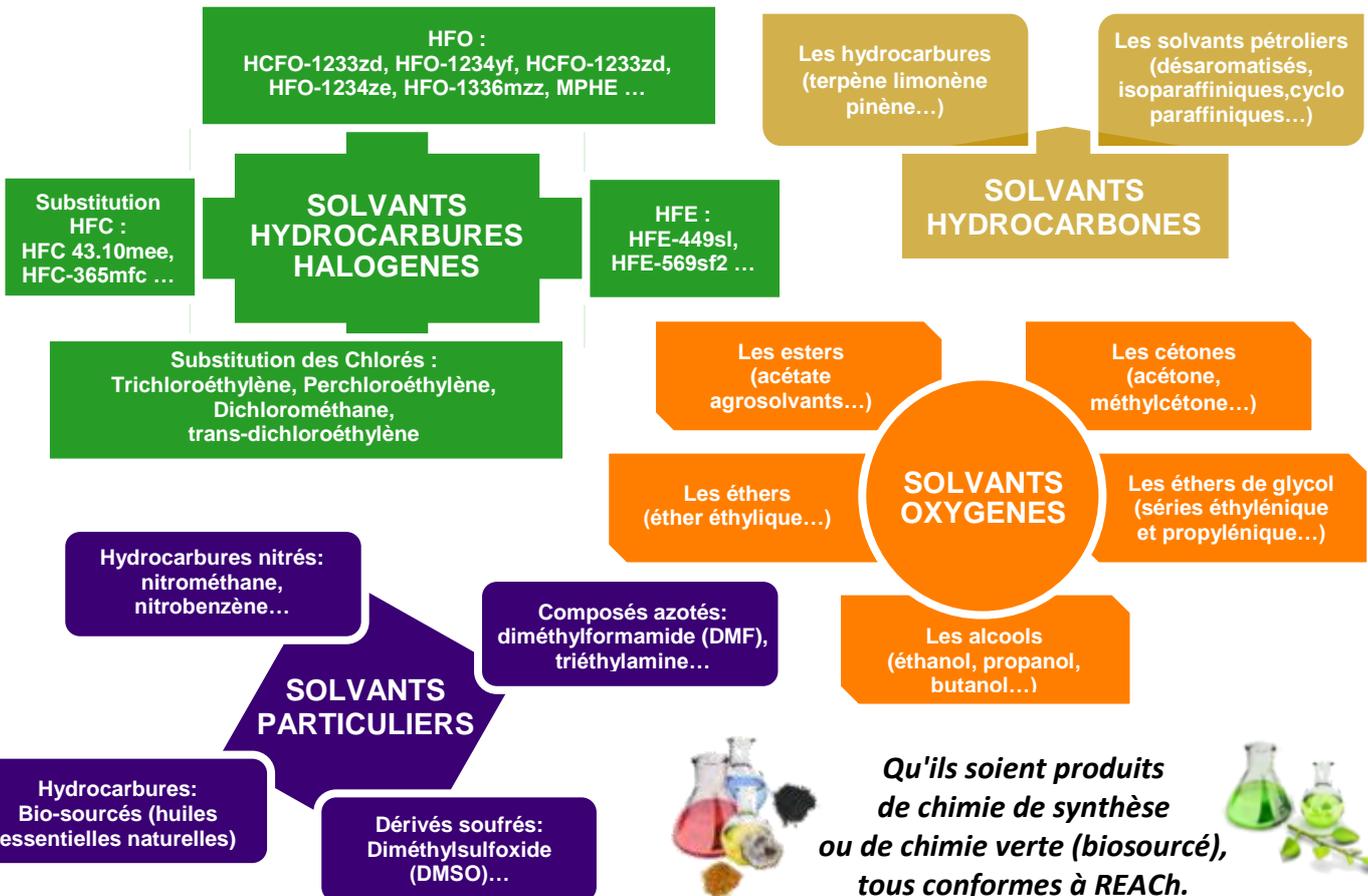
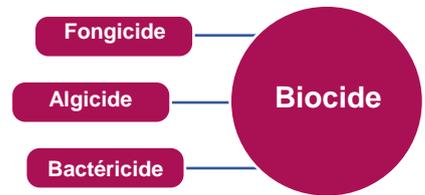
- Une absence ou une très faible odeur
- Une faible tension superficielle
- Une toxicité faible
- Faible conductivité électrique
- Point d'écoulement très bas
- Une très faible teneur en composés aromatiques.

Les SERSOLV® AP et Les SERSOLV® X sont une base très intéressante pour la formulation de nombreux produits de dégraissage, départiculage et défluxage dans les hautes technologies.

Principales solutions industrielles utilisées pour les formulations dans le domaine du nettoyage de très haute précision.



## DEGRADATIONS BIOLOGIQUES



*Qu'ils soient produits de chimie de synthèse ou de chimie verte (biosourcé), tous conformes à REACH.*

*Issus de grands producteurs, Français, Européen ou des leaders de la chimie mondiale.*



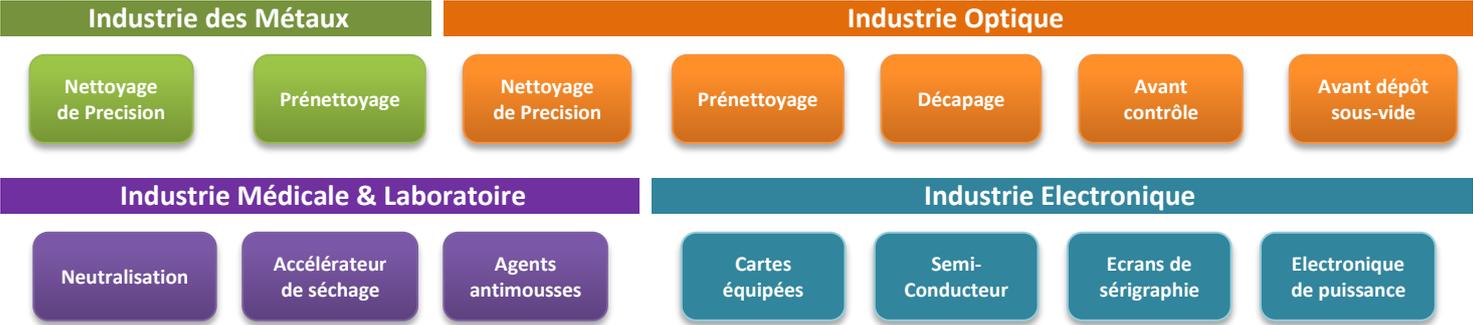
**Matériaux Compatibles :**

Acier Inoxydable - Alliages Frittés - Aluminium Anodisé - Argent - Bronze - Céramique - Chromé Mat - Cuivre  
Gomme - Laiton - Matière Plastique - Matières Synthétiques - Métal non ferreux - Nickel - Or - Platine  
Silicone - Titane - Verre minéral / organique - Zinc

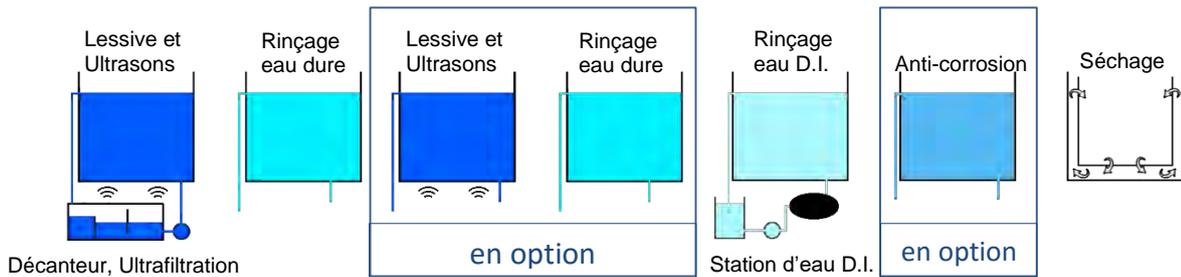
**Polluants Dissous :**

Bactéricide - Cires - Colles - Couches de laques dure - Couches de revêtement antireflets - Empreintes de doigts  
Fongicide - Graisse - Laques de protection - Marquages - Mastics - Moule - Oligomères  
Pâtes à polir - Polygomères - Polymères – Résidus du stockage - Résines - Poussières

## GAMME LESSIVES



**LIGNE LESSIVIELLE DE NETTOYAGE**



## GAMME MANUELLE

Parmi une gamme de produits :

Pour des applications comme :

**Biodégradable**

- Dégraissage - Nettoyage de finition
- Défluxage - Nettoyage des CI
- Nettoyage d'écrans de sérigraphie
- Nettoyage de finition
- Préparation de surface
- Entretiens équipements
- Avant collage, soudage, peinture ...
- Maintenance Réparation

**Eco-solvant**

**Sans COV**



**Asperson**

**Fontaine**



**Aérosols**



**Lingettes**



**Bidons / Flacons**



**Fûts**



**Pinceau**



**Bac Ultrason**

## PAPIER DE NETTOYAGE



DEK®  
EKRA®  
FUJI®  
INNOTEC®

MPM®  
PANASONIC®  
SAMSUNG®  
SPEED PRINT®  
YAMAHA®

## DÉPOUSSIÉRANTS- NETTOYANTS

CHEMTRONICS  
JELT  
KIWO

TECHSPRAY  
VIGON  
CRC  
KF



## COLLAGE – BRASAGE - FLUXAGE



Alliage – Fils - Colle CMS  
Flux – Pâte – Crème – Soudure  
Etamage - Alcools

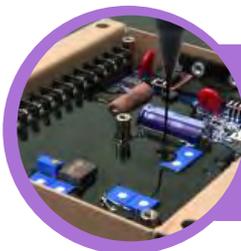
Heraeus – Loctite - Koki  
Sodiflux - MBO

## PROTECTION ESD

Produits Salle Blanche  
Aménagement Poste de travail  
Equipements de test  
Equipement de la personne  
Connexions sécurisées



## SILICONE DE PROTECTION

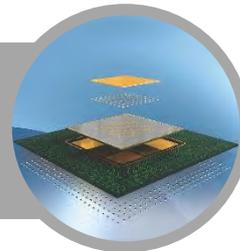


Vernis de Tropicalisation  
Résine d'Encapsulation  
Colle rapide  
Protection Primaire  
Silicone Etanchéification



## SEMICONDUCTEUR SPECIALITE

Colles conductrices  
Pâte et Sphère pour Bumping  
Encre Conductrice  
Encre Isolante  
Colle Argent  
DIE et Clip Attach



## MASQUAGE ELECTRONIQUE



Kapton  
Vernis épargne  
Masque pelable  
Pastille adhésive  
Ecran Thermique



## GRAISSE - PATE SILICONE

Dissipation thermique  
Pâte isolante  
Krytox  
Pâte de protection  
Graisse fluorée  
Fomblin



## SOLVANT / LESSIVE

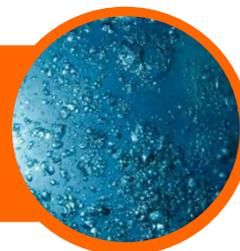


HFE  
Novec  
Sersolv  
Vertrel  
Biosane  
Promosolv

Dowcleane  
Opteon  
Topklean  
Calden  
HFC  
Novaspray

## FLUIDE ELECTRONIQUE

Brasage en phase vapeur  
Bubble tests  
Galden  
Choc Thermique  
Fluorinerte  
Transfert thermique



## EQUIPEMENTS



Etuve  
Four de refusion  
Brasage à la Vague  
Enceinte Climatique  
Soudage Réparation  
Outillage à main

Machine :  
de Nettoyage  
de Dépose  
de Serigraphie  
de Test  
de Contrôle

CECI EST UNE PARTIE  
DE LA GAMME, POUR PLUS DE PRECISIONS  
CONTACTEZ-NOUS.

**POUR APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES**



0.1mm



FILS	TYPE DE FLUX	HALOGENE	Norme J-STD-004	Nettoyage
INOXY plein	Sans flux			
INOXY	C	SANS	ROL0	Clean
INOXY R	CMA	SANS	ROM0	Clean
		AVEC	ROM1	
INOXY T	CA	AVEC	ROH1	Clean
INOXY S	Synthétique		RE	Clean
INOXY-H	Organique	SANS	ORM0	Clean
		AVEC	ORH1	
	Inorganique		IN	
INOXY-NET	A faible extrait sec	SANS	ROL0	No Clean
		AVEC	ROM1	
		SANS	REL0	
		AVEC	REM1	

<b>FLUX</b>	1.0% – 3.0%
<b>HALOGENES</b>	0.0% – 5.0%
<b>DIAMETRE</b>	0.1mm – 3.0mm
<b>POIDS</b>	50g – 1kg
<b>NETTOYAGE</b>	à l'eau au solvant

Alliages sans Plomb	Alliages	Point de Fusion		Champs d'application
		Solidus	Liquidus	
	Sn95.5Ag3.8Cu0.7	E - 217°C		Soudure industries alimentaires, plomberie, électronique, connectique, industrie des lampes condensateurs...
	Sn96Ag3.5Cu0.5	217°C - 219°C		
	Sn96.5Ag3.5	E - 221°C		
	Sn99.3Cu0.7	E - 227°C		
	Sn97Cu3	227°C - 320°C		
	Sn99Ag0.3Cu0.7	217°C - 227°C		
	Sn95.5Ag4Cu0.5	217°C - 225°C		

Alliages avec Plomb	Alliages	Point de Fusion		Champs d'application
		Solidus	Liquidus	
<b>NORMAL</b>	Sn63Pb37	E - 183°C		Soudure industrielle dans l'électronique, Yh`U`connectique. A ffcgdUh]U`Yz`U`ffcbUi h]ei Yz`Ui hca cV]Yz`a ]]HJ]fYz` médical...
	Sn60Pb40	183°C - 190°C		
	Sn50Pb50	183°C - 216°C		
	Sn40Pb60	183°C - 238°C		
<b>TRIMETAL</b>	Sn60Pb38Cu2	183°C - 190°C		Etamage de fils de cuivre, application câblage automobile. Améliore les caractéristiques mécaniques des joints. Réduit l'usure des pannes de fers.
	Sn60Pb39Cu1	183°C - 190°C		
<b>SILVER</b>	Sn62Pb36Ag2	178°C - 180°C		Soudure électronique sur circuits dorés. Alumine sérigraphiée à l'argent. Point de fusion basse température Haute conductivité pour les applications CMS et la retouche.
	Sn60Pb37Ag3	178°C - 180°C		
<b>Alliages haute température</b>	Pb90Sn10	270°C - 300°C		Soudure à haut point de fusion pour l'industrie XYg`Ua dYg`Yg`a chYi fgz`U`a fWb]ei Yz`ci `Yg`gci Xi fYg` nécessitant un joint plus maléable"
	Pb93.5Sn5Ag1.5	296°C - 301°C		
	Pb80Sn18Ag2	179°C - 280°C		
	Pb93Sn5Ag2	296°C - 301°C		
<b>Alliages basse température</b>	Sn50Pb32Cd18	E - 145°C		Soudure basse température pour substrats fragiles (céramique argentée), ou points juxtaposés. 7cb, i `dci f`Yg`W`a dcgUbhg`h`Yfa ]ei Ya Ybh`gYbg]V`Yg`
	Sn43Pb43Bi14	144°C - 163°C		

Flux sans Nettoyage "NO CLEAN"	Halogènes	Résines Synthétiques & Modifiées
Les résidus de ce qu'on appelle les flux "sans nettoyage" peuvent rester au niveau du joint de soudure. Des réactions corrosives au niveau du joint de soudure ne sont pas attendues. Lors de l'utilisation des flux hautement activés, les résidus peuvent être enlevés après la soudure, sinon des phénomènes de corrosion peuvent se produire au niveau du joint de soudure.	Un flux de brasage contenant des halogénures, est généralement plus actif qu'un flux sans halogènes. Les fils activés avec des halogénures sont habituellement remarqués lors du brasage par un meilleur mouillage. Les fils sans halogènes et leur résidus sont généralement considérés comme nettement moins sensibles à la corrosion sur le joint de soudure.	Les résines synthétiques et les résines modifiées se caractérisent par le fait qu'elles sont plus stables thermiquement que les résines colophanes naturelles. Elles laisseront, en général des résidus plus brillants sur le joint de soudure, si les conditions d'utilisation sont respectées.



Barres	Baguettes
Lingots	Grenailles

Alliages Standards		
Sn63 PB	Sn60PB	Sn62 Pb Ag2
Sn50 Pb Bi3	Sn63 G2	Sn60 Pb Bi
Alliages Haute température		
Sn30SP	Sn 60 HT	Sn5Pb93.5Ag1.5

Alliages Sans Plomb 	Sn99.3 Cu0.7	Sn96.5 Ag3.5	Sn95.5 Ag3.8 Cu0.7
	Sn99 Cu HT	Sn99 Ag0.3 Cu0.7	Sn96.5 Ag3 Cu0.5

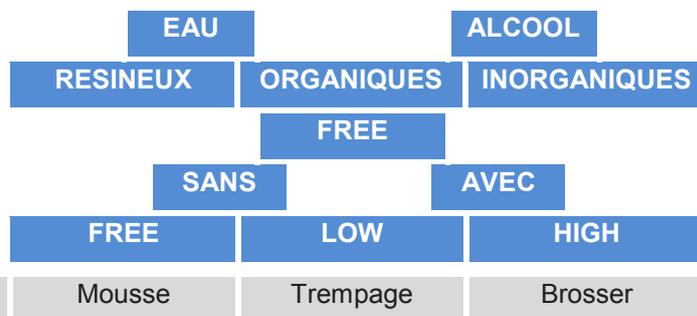
Les Alliages sont compatibles avec tous les équipements de soudage : les creusets à étamer, les simples vagues, double vague inertée ou non (CMS, Laminaires ou Worthmann), les machines à souder, les machines d'étamage électrolytique, au rouleau, HAL

## Flux



Stylo à flux

BASE DU FLUX  
NATURE  
HALOGENE  
NETTOYAGE  
COV



Les flux Hydrosolubles	Les Flux Résineux	Les Flux no-clean Base Alcool	Les Flux no-clean Base Eau
<p>Organiques ou inorganiques, ils sont efficaces et généralement chargés en halogènes.</p> <p>Les résidus, lavables à l'eau doivent être éliminés afin d'éviter tout risque de contamination et de corrosion dans le temps.</p> <p>Pour le soudage de pièces fortement oxydées ou de supports à faible mouillabilité.</p> <p>Ils sont généralement employés dans l'assemblage de pièces mécaniques.</p>	<p>Type :</p> <p>Colophane Colophane Moyennement Activé Colophane Activé</p> <p>Permet l'étamage au trempé (fils de cuivre, cosses).</p> <p>Ces flux chargés en colophane et le solvant principal sont à base d'alcool.</p>	<p>Sans résidus et sans nettoyage à faible extrait sec (&lt;4%).</p> <p>Permet l'étamage au trempé (fils de cuivre, cosses)</p> <p>Adaptés à tous les systèmes de soudage, automatique ou manuel, ils sont particulièrement destinés à la soudure de composants (CMS ou traversées) sur circuits imprimés.</p>	<p>Sans résidus et sans nettoyage à faible extrait sec (&lt;4%).</p> <p>Réduction des composés organiques volatiles (C.O.V.).</p> <p>Ces flux sont particulièrement adaptés aux machines à la vague équipées de fluxeurs spray compte tenu de la faible quantité nécessaire pour une bonne activation.</p>

**POUR LES MACHINES AUTOMATIQUES A LA VAGUE OU AU TREMPE.**

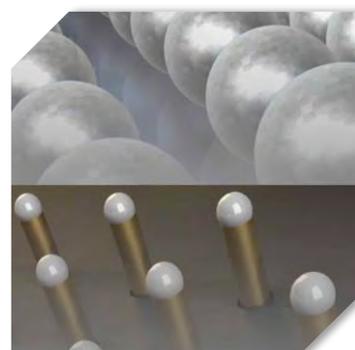
## Alliages disponibles<sup>1</sup>

Alliage	Point de fusion (°C)		PCB	Ceramic	RoHS
	Solidus	Liquidus			
Sn95Sb5	235	240	+		
Sn96.5Ag3.5	221	Eutectique	+	+	
Sn96.5Ag3 Cu0.5	217	220	+		
Sn95.5Ag3.8Cu0.7	217	Eutectique	+	+	
SnAg2.5Cu0.5	206	218		+	
Sn99Ag0.3Cu0.7	217	227	+		
Sn98.5Ag0.8Cu0.7	217	224	+		
Sn99CuSP	227	Eutectique	+		
Sn43Bi57	139	Eutectique	+		
Sn42Bi57,6Ag0,4	139	Eutectique	+	+	
Sn42Bi57Ag1	139	Eutectique	+	+	
Sn62Pb36Ag2	179	Eutectique	+	+	
Sn63Pb37	183	Eutectique	+		
Pb92,5Sn5Ag2,5	296	301	+	+	
Sn18Pb32Bi50	98	Eutectique	+		

<sup>1</sup>Autre alliage sur demande

## Taille de Particules disponibles

Type de poudre	Taille de poudre	Pas entre connecteurs (mm)	Diam. Point de dépose
II	45-75µ	0.65	0.80 (mm)
III	25-45µ	0.50	0.50 (mm)
IV	20-38µ	0.30	0.30 (mm)
V	15-25µ	0.20	0.25 (mm)
VI	5-15µ	0.10	0.10 (mm)



## CRÈMES À BRASER AVEC PLOMB

Flux	Sans Nettoyage			Nettoyage à l'eau	
	F381	D377	F917	F10	F541
Nom	F381	D377	F917	F10	F541
Application(s)	Sérigraphie	Sérigraphie / Dispensing	Dispensing	Sérigraphie	Sérigraphie / Dispensing
Propriété					
Sans halogènes		(+)			
Refusion sous azote (N <sup>2</sup> )	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion sous air	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion phase vapeur		(+)			(+)
Classification J-STD-004	M1	L0	L0	L0	H1
Résidus très clairs	(++)	(++)	(+)	(++)	N/A
Alliage Anti-Tombstone	(+)		(+)		



## CONDITIONNEMENT

Seringues

Cartouches

Pots

## CRÈMES À BRASER SANS PLOMB

Flux	Sans Nettoyage				Nettoyage à l'eau		
	F640	F645	F620	F169	SOP91121	WL449	F541
Nom							
Application(s)	Sérigraphie / Dispensing	Sérigraphie / Dispensing	Sérigraphie	Dispensing	Sérigraphie	Sérigraphie	Sérigraphie
<b>Propriété</b>							
Sans halogènes		(+)		(+)		(+)	
Refusion sous azote (N <sup>2</sup> )	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion sous air	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)
Refusion phase vapeur	(+)	(+)	(+)		(+)	(+)	(+)
Classification J-STD-004	L0	L0	L1		L0	H0	H1
Mouillabilité sous air	(+)		(+)		(+)	(+)	(+)
Mouillabilité sur Ni, sous air	(++)	(+)			(+)	(++)	
Résidus très clairs			(+)		(+)	n/a	n/a
Réduction des voids sous BGA			(+)		(+)		
Réduction des voids sur grande plages	(+)				(+)		(+)
Nettoyage facile à l'eau						(++)	(+)
Utilisation pour du Direct Copper Bonding		(+)				(+)	

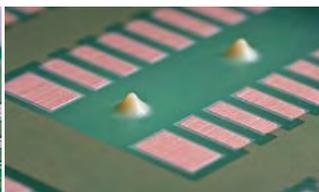
## GEL À BRASER

Flux	Sans Nettoyage				Nettoyage à l'eau		
	NC 5070	SF36	SF64	SURF 20	TF 38	TFD 54	WSD 3810-CFF
Nom							
Application(s)							
Réparation manuel, seringue	+	+	+		+	+	+
Réparation manuel, stylo				+			
Flip Chip, trempé (dipping)	+				+		
<b>Propriété</b>							
Sans halogènes	+	+	+	+	+		+
Pâte ou gel	+	+	+		+	+	+
Liquide				+			
Classification J-STD-004	L0	L0	L0	L0	L0	H1	H0
Couleur des résidus de flux	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Extrêmement transparent	n/a	n/a
Compatible avec Underfill i.e. : flip-chip/CSP sur PCB's					+		
Teneur en solides (%)	60	50	60	2.2	18	n/a	n/a
Mouillabilité	+	+	++		+	+	++
Pouvoir collant	++	+	+		+		++



## CONDITIONNEMENT

Seringues



## CMS adhésifs

Types de colles	PD955PY	PD955PRM PD955PRH	PD955M	PD205 A-Jet	PD944	PD977	PD208PR	PD208M
<b>Applications</b>								
Impression par pochoir Distribuer <sup>1)</sup>	++	++	++	++ <sup>2)</sup>	+	+	++	++
Pin-transfert		+			++			
<b>Processus</b>								
Force d'adhérence élevée.	++	+(PRM) ++(PRH)					+	
AOI (inspection optique automatique)		++	++	++	++	++	++	++
Brasage sans plomb	++	++	+	+	+	+	+	+
Avec une bonne adhérence des composants difficiles à coller	+	+	+	+	+	+	+	+
Rapide ou faible température de durcissement SMT adhésif						+		
Nettoyage facile de pochoirs Recommandé pour BGA / CSP (liaison d'angle)	+	+(PRM)	+			++	+	
<b>Propriétés physiques</b>								
Sans halogènes							++	++
Couleur	jaune	rose (PRM) rouge (PRH)	rouge	rouge	rouge	rouge	Orange	rouge

1) Pour diodes de verre critiques, PD 860002 SPA est recommandée.

2) Recommandée pour la distribution avec Jet-distributeur (par exemple Asymtek, Mydata)

# Colles Techniques

## ÉLECTRONIQUE

Pour vos applications de collage et enrobage nous vous proposons des colles, UV, polyuréthanes, époxy, résines silicones ...

- Collage / enrobage d'optiques LED
- Résine d'enrobage
- Dissipation thermique
- Fixation des cartes
- Colle Die Attach
- Colle conductrice anisotrope
- Protection des vibrations
- Vernis de tropicalisation
- Collage d'écrans LCD
- Étanchéité des connecteurs
- Glob Top
- Joint d'étanchéité
- Optoelectronique
- Collage CMS
- Dam & Fill®



## MÉCANIQUE

Les colles techniques sont un élément à part entière de l'assemblage, de la protection de vos pièces.

- Colle UV
- Colle Époxy
- Lubrification
- Mastics
- Colle Structurale
- Colle Anaérobie
- Colle Freinage
- Colle Acryliques
- Colle Méthacrylate
- Colle Polyuréthane
- Colle Cyanoacrylate
- Colle Hot Melt Thermofusible



# Résines - Silicones - Colles Mastics - Elastomères

Des produits et des solutions exclusives pour les applications industrielles.  
Un effort continu de recherche et d'amélioration qualitative des produits réalisés par les producteurs.

Des **ELASTOMERES SILICONES MONOCOMPOSANT** utilisables pour le jointoyage, le collage, l'amortissement, l'isolation, l'imprégnation, l'anti-adhérence, l'étanchéité et le scellement.

Des **ELASTOMERES SILICONES RTV-2, LSR** utilisés dans la confection de moules élastiques, de produits moulés et pour le scellement de composants électroniques.

Des **Catalysateurs et additifs pour RTV-2**

Des **EMULSIONS** utilisables comme agents anti-mousses, agents de démoulage, antifrictions, hydrofuges, additifs pour produits d'entretien, améliorants du brillant dans les industries alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, des matières plastiques, textiles et papiers.

Des **GRAISSES et des PATES** de lubrification, d'encapsulation, d'évacuation de chaleur et de protection pour des isolateurs dans l'industrie, la médecine et l'artisanat.

Des **RESINES** agents anti-adhérents, liants et hydrofuges, protection contre l'humidité des composants électroniques.

Des **HUILES** lubrifiantes garantissant le glissement entre métaux, matières plastiques et caoutchoucs à températures extrêmes, comme diélectriques, huiles hydrauliques et huiles d'amortissement, etc.

Des **PATES SILICONES, des AEROSOLS**, agents de démoulage et anti-adhérents à usages divers.

Des **PRIMAIRES** pour l'adhérence sur tous types de substrats.

Des **RESINES, des COLLES, des VERNIS** époxy, polyuréthane, cyano, vinylique, acrylique, fluoré bi-composantes et mono-composantes utilisés pour les collages structuraux de matériaux identiques ou différents.

Avec des produits de différentes viscosités, pot life, couleur et dureté shore afin de répondre aux contraintes des applications d'assemblages.



Pour l'aérospatiale, l'électronique, le médical, l'automobile, l'assemblage industriel, la fabrication de moules etc...

DEHESIVE®, ELASTOSIL®, GENIOMER®, GENIOPERL®, GENIOPLAST®, GENIOSIL®, HDK®, INTEGRISIL®, POWERSIL®, PULPSIL®, SEMICOSIL®, SILFOAM®, SILMIX®, SILPURAN®, SILRES®, Wacker-Belsil®, WACKER SilGel®, WETSOFT®, SYLGARD®, SILASTIC®, RHODORSIL®, SILBIONE®, CAF®, BLUESIL®, RTV, TSE



CETTE BROCHURE NE REPRESENTE QU'UNE PARTIE DE LA GAMME, POUR PLUS DE PRECISIONS CONTACTEZ-NOUS.



CECI NE REPRESENTE QU'UNE PARTIE DE LA GAMME, POUR PLUS DE PRÉCISIONS CONTACTEZ-NOUS.

## NETTOYAGE / DEGRAISSAGE / DEFLUXAGE



Solvant Fluoré - Phase Vapeur  
Solvant Pétrolier / Alcool Modifier - A3  
Ligne nettoyage Aqueux  
Fontaines de nettoyage  
Distilleuse  
Multi Cuves



## TRAITEMENT DE SURFACE

Four de traitement / Etuves  
Traitement de Métallisation  
Peinture / Brunissage  
Sablage / Grenailage  
Dépôt de Couches Minces  
Traitement Plasma



## FABRICATION ADDITIVE 3D



Fabrication additive 3D Métal  
Impression 3D "FDM" - Fil  
FA 3D Céramique "CIM"  
Impression 3D "SLS"  
Impression 3D - Résine



## ELECTRONIQUE / MICROELECTRONIQUE

Machines de placement CMS  
Machine de brasage à la Vague  
Station Soudage / Dessoudage  
Machine de sérigraphie  
Machin de Refusion  
Machin Phase Vapeur



## DECOUPE / GRAVURE / MARQUAGE



Impression 2D & Découpe  
Découpe Laser  
Thermoformage  
Découpe au Jet d'eau  
Gravure & Marquage Laser



## CELLULES ROBOTIQUES / MACHINES CNC

Routeurs CNC  
Centres d'usinage  
Tour / Fraiseuses CNC  
Cellules robotiques d'usinage  
Cellules robotiques de soudure



## SILICONE / RESINE / COMPOSITE



Machine Injection & Infusion  
Systemes de Dosage  
Systemes de Depose  
Lampe UV / Pistolet  
Melangeur / Seringue



## EQUIPMENTS FLUIDES

Compresseurs / Compteurs  
Flexibles / Pompes / Raccords  
Solutions d'étanchéité  
Graisseur automatique  
Distribution d'huile



## SCANNER 3D / MESURES / ANALYSES



Scanner 3D  
Etalonnage  
Mesures dimensionnelles  
Colonnes de Mesure  
Microscope Digital  
Bancs d'essai, Etenchéité/Thermique



## SALLE BLANCHE / LABORATOIRE

Unité de filtration / Filtres à Air  
Hotte Aspirante  
Armoires de stockage  
Vêtements  
Protection ESD  
Racks Mobiles / Chariots



## OUTILS / STOCKAGES



Armoires de déshumidification  
Vitrines de stockage Azote  
Coupe / Dénudage sertissage câbles  
Pinces de scellement  
Plaques Chauffantes / Balance  
Outils de prehension

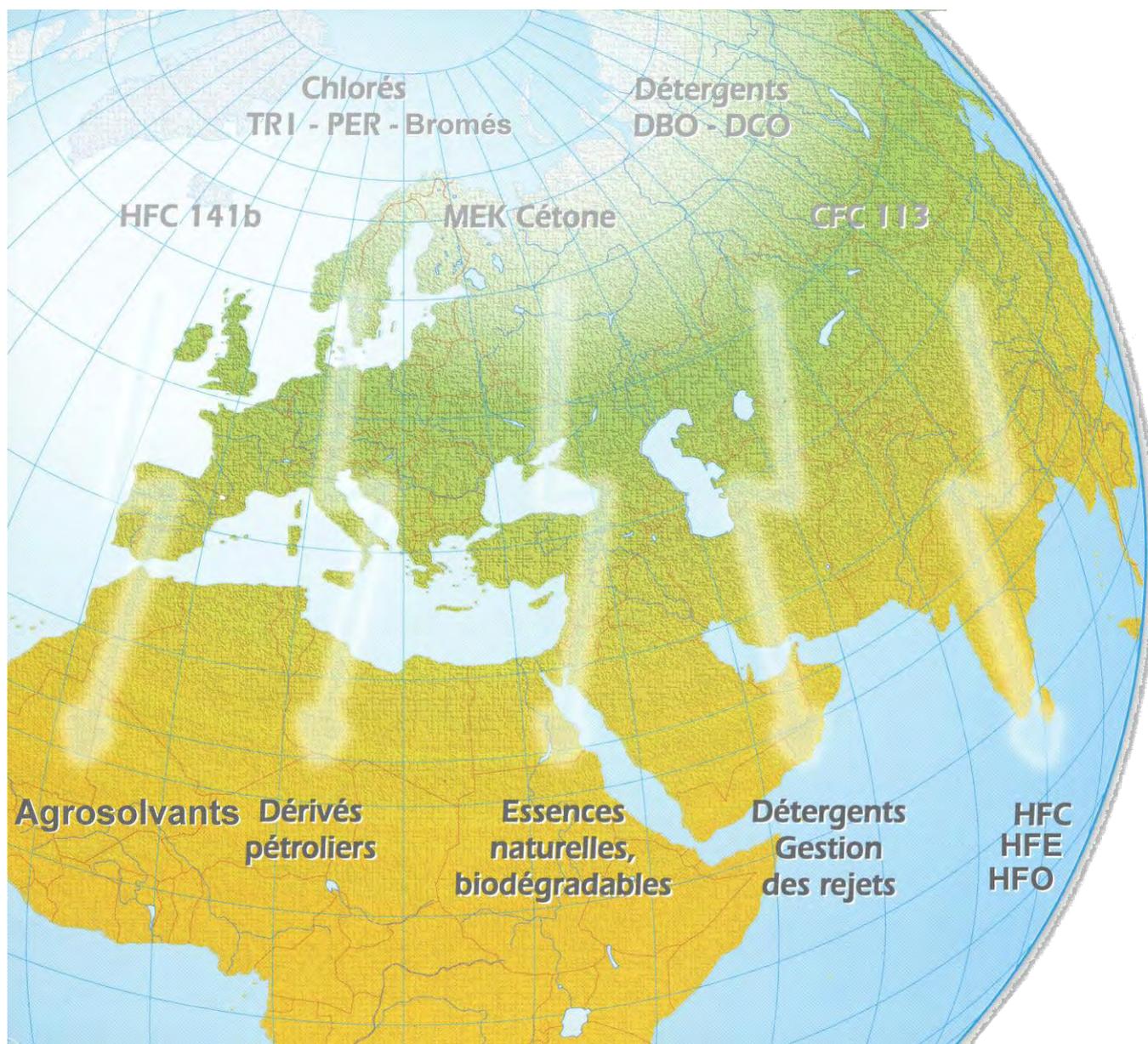
CECI EST UNE PARTIE  
DE LA GAMME, POUR PLUS DE PRECISIONS  
CONTACTEZ-NOUS.

# Limitation, interdiction d'utilisation de vos produits actuels (ODP-VOC, sécurité, toxicologie,...)

## Que choisir pour l'avenir ?

Pour aborder demain avec clarté et trouver votre solution, contactez nos équipes spécialisées :

● **COMMERCIAL**   ● **MATERIEL**   ● **LOGISTIQUE**   ● **ENVIRONNEMENT**   ● **TECHNIQUE**



5, Place de l'Eglise  
77400 Saint Thibault des Vignes  
Tél : 00 33 (0)1 64 30 89 22  
Fax : 00 33 (0)1 64 30 87 49  
E-Mail : [contact@service-chimie.fr](mailto:contact@service-chimie.fr)  
Web : [www.service-chimie.fr](http://www.service-chimie.fr)

 **service chimie**